



HOME > ニュース > 2024年 > JSRの低誘電樹脂材料「ELPAC® HC-G Series」が第20回JPCA賞（アワード）を受賞しました！

JSRの低誘電樹脂材料「ELPAC® HC-G Series」が第20回JPCA賞（アワード）を受賞しました！

2024年06月10日 企業情報

JSR株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO兼社長：エリック・ジョンソン）はこの度、「高速通信基板向け熱硬化性低誘電樹脂の開発」で、第20回JPCA賞を受賞しました。受賞した高速通信基板向け熱硬化性低誘電樹脂は「ELPAC® HC-G Series」として販売を開始しており、低誘電性のみならず、密着性、耐熱性、熱硬化性、信頼性を兼ね備えています。高速伝送用CCLやIC基板用の原料として業界に貢献することへの期待が評価され、この度の受賞に至りました。

詳しくは以下のリンクよりJPCAから発表された情報をご覧ください。

https://www.jpca-show.com/show2024/jp/event/jpca_award.html

JPCA賞は、『独創性（独自性・オリジナリティ）』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時代の適合性』を審査基準として、学术界、電子回路業界、専門誌編集者等で構成するJPCA 賞選考委員会によって審議されます。当社は昨年度の界面分子結合材「MOLTIGHT IMB®」に続き、2度目の受賞となりました。

表彰式は、6月12日（水）16時45分よりJPCA Show 2024（会場：東京ビックサイト）で開催されます。また、会期中は今回受賞した高速通信基板向け熱硬化性低誘電樹脂「ELPAC® HC-G Series」や、昨年受賞した界面分子結合材「MOLTIGHT IMB®」をはじめとした先端実装材料を当社ブースで展示いたします。

当社は、独自の材料設計や製造ノウハウの活用、さらにはオープンイノベーションも取り入れることで迅速にソリューションを開発、提供してまいります。

< [ニュース一覧へ戻る](#)